



シリコーンブランケット「#700-STD」

ファインライン印刷技術

For Printed Electronics

近年、新聞や雑誌を印刷するように、印刷技術を用いて電子回路等のエレクトロニクス製品を大量かつ低コストで製造する次世代の技術として期待されています。

◆グラビアオフセット印刷

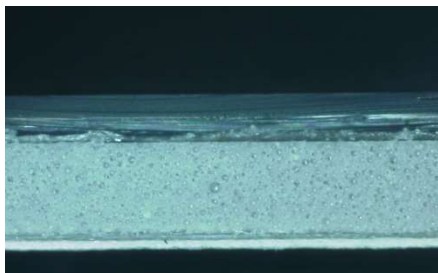
グラビア印刷とオフセット印刷を組合せた印刷方法です。

- ①ドクターブレードによりペーストを彫刻したパターン(グラビア版)の中に充填します。
- ②凹版上でブランケット胴を転がすとペーストがブランケット胴上に受理(オフ)します。
- ③ワークの上でブランケット胴を転がすとインキが転写(セット)されます。

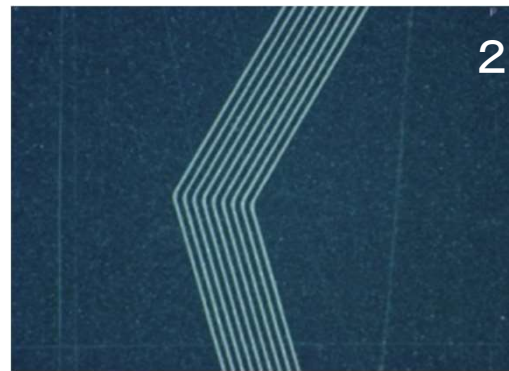
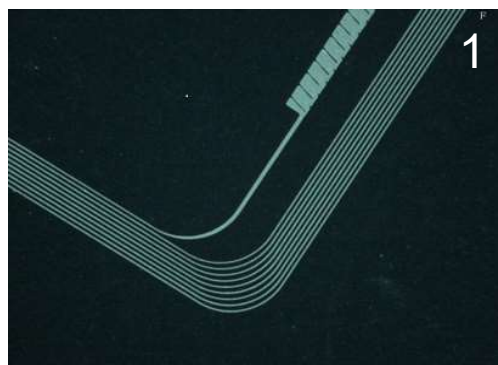
◆特徴

- ①版より受理したペーストを100%ワークへ転写できます。
- ②表面の平滑さ: ブランケットの表面を特殊加工し、微小領域での表面粗さはRa<数10nmです。
- ③界面特性のコントロール(受理転写のバランス制御)で、膜厚均一性の高い印刷が可能です。

標準仕様(断面)



印刷例(社内印刷サンプル)



タイプ: #700-STD

表面ゴム: シリコーンゴム

臨界面張力

γ_c = 約22 dyne/cm



1: 銀配線 ファインライン
L/S = 30 μ m / 30 μ m (50倍)

2: 銀配線 ファインライン
L/S = 30 μ m / 30 μ m (100倍)

3: 銀配線 メタルメッシュ
L/P = 7 μ m / 300 μ m (175倍)

◆総厚: 1.7mm、2.3mm

(アンダーブランケット貼り合わせ時)

◆テスト印刷: 受託加工可能。

◆詳細仕様等: お問い合わせ下さい。

藤倉コンポジット株式会社

次世代技術開発部 事業開発チーム(杉本・棟田)

〒339-8510

さいたま市岩槻区上野1-12-8

TEL 048-794-2940

FAX 048-794-2618

kaihatsu@fc.fujikura.co.jp

銀ペーストご提供: 藤倉化成株式会社様